**令和　　年　　月　　日**

　　　　　工事名

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

シーカプラン防水システム施工要領書

|  |  |
| --- | --- |
| 仕　　　様 | IW断熱工法 |
| 仕様記号 | 20G-IW-S（断熱材：発泡ポリスチレン） |
| 下　　　地 | RC |

施工会社

材料販売会社

目 　次

１ 　・・・・・　 　総　　則

２ 　・・・・・　 　工事概要

３ 　・・・・・　 　工事体系

４ 　・・・・・　 　防水仕様及び使用材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　　・・・・・　　　施工方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　・・・・・　　　安全管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７　　・・・・・　　　添付資料

**１．　総則**

　　　　○　本施工要領書は【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】内のシーカプランIW断熱工法機械的固

　　　　　　 定工法に適用するものであり、記載無き事項は設計図書及び標準仕様書に従い不備無きこと

を確認の上施工する。

○　材料の品質に不具合を確認した場合は速やかに担当者に報告する。

　　　○　施工上の都合により本施工要領書の記載事項に変更が生じた場合は、監督者と協議の上

　　　　 その承諾のもとで施工する。

　　　○　工事においてその関係者は仕様及び納まりその他連絡事項を周知徹底し、責任をもって上質

　　　　 　　で安全な施工を心がけて作業する。

**２．　工事概要**

　　　工事名称

　　　　所在地

　　　　発注者

　　　　設計 ・ 監理

　　　　元請業者

　　　　防水施工業者

　　　　工期　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日

**３．　工事体系**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 発注者 | |  | | |
|  | | |  |
|  | | 元請 | |  | |  |
|  | | | |
| 防水材メーカー  シーカ・ジャパン株式会社 |  | 防水業者 | |  | | |
|  |
|  |  |  | | | |
| 現場担当者 | |  | 施工班 | |
|  |

**４．　防水仕様及び使用材料**

**４－１　防水仕様**

　　　　　　【　平場　】

|  |  |
| --- | --- |
| 工　法 | 断熱機械的固定工法 |
| システム記号 | 20G-IW-S |

　　　　　　【　立上り　】

|  |  |
| --- | --- |
| 工　法 | 接着工法 |

**４－２　使用材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料名** | **規　格** | **備　考** |
| シーカプラン 20G | 幅1.54m×長さ10m  厚さ 2.0mm | 塩化ビニル樹脂系防水シート  色： |
| IWディスク | φ91mm | IW自動加熱システム専用  ディスク板 |
| IWディスクスペーサー | φ110mm  厚さ 1.0mm | IWディスク板下に設置 |
| SPLディスク | φ100mm | 断熱材固定用ディスク |
| SPL-K1 | 幅55mm×2m | 塩ビ被覆鋼板フラットバー |
| SPL-K6 | 55mm×15mm×2m | 塩ビ被覆鋼板　入隅部に使用 |
| SPL-K7 | 80mm×50mm×10mm×2m | 塩ビ被覆鋼板  立上り天端部に使用 |
| **材料名** | **規　格** | **備　考** |
| SPLドレン鋼板 | 455mm×455mm φ110mm穴 | 縦・横ドレン部に使用 |
| SPL アルミテープ | 25mm×50m | SPL塩ビ鋼板接合部・切り使い部用絶縁テープ |
| SPLスクリュー | φ7×50mm | 立上り塩ビ被覆鋼板の固定に使用 |
| SPLスクリュー | φ7mm×70mm,80mm,95mm,120mm | IWディスク板、塩ビ鋼板（平場側）およびSPLディスク板の固定に使用 |
| SPLボンド | 15kg／缶 | ニトリルゴム系接着剤  シーカプランGと下地の接着用 |
| ブチルテープ | 厚さ：1.0mm  幅：30mm  長さ：15m | 定型シール材  防水末端部のシーカプランG  裏面に使用 |
| SPLエマルション100 | 18ｋg／缶 | アクリルエマルション系接着剤  （SPLマット、SPL防湿シートに使用する場合あり） |
| 断熱材  ポリスチレンフォーム | 910mm×1820mm  厚さ mm | ポリスチレン系断熱材 |
| SPL防湿シート  （必要な場合） | 2m×50m  厚さ 0.15mm | 断熱材と下地間に敷設  （平場のみ） |
| SPLマット | 1.2m×100m厚さ2.0mm | シーカプランと断熱材の絶縁シート |
| SPLテープ | 50mm×50m | SPLマット接合部用PPテープ |
| SPLドレン/大/本体/  φ100mm用 | 外径φ250mm | 塩ビ製改修用ドレン  既存φ100mm用 |
| タイダクトホースGL-2  φ86mm用 | 長さ 5m | 縦・横ドレン用フレキシブルホース  （現場で任意の長さにカット） |
| 塩ビパイプ用ボンド | 100g／缶 | SPLドレンとタイダクトホース  接合用接着剤 |
| SPLストレーナー/縦型 | － | アルミダイキャスト製縦ドレン  ストレーナー |
| **材料名** | **規　格** | **備　考** |
| SPLコーナーパッチA | - | 出隅部増張り用シート成形品 |
| SPLコーナーパッチB | - | 入隅部増張り用シート成形品 |
| SPL溶着剤 | 4L、16L／缶 | シーカプラン相互、SPL塩ビ鋼板の溶着に使用 |
| シームシーラント | 1L／缶 | シート相互の接合部用シール |
| SPL-A　各種 | L= 2000mm | アルミ金物　各種 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**５．　施工方法**

**５－１　施工前の確認及び注意事項**

　　　　○　施工下地の不陸　・　突起　・　段差　・　脆弱な部分などがないか点検し、撤去や補修について

　　　　　　　は打合せの上その方法を決定する。

　　　　○　既存防水層がある場合は膨れ・水溜りなどを補修し、出来る限り平滑な下地を作る。

　　　　○　ルーフドレン周辺は水はけが良いか確認し、不備があれば打合せの上補修する。

**５－２****シーカプラン断熱防水システム 施工法**

　　　　（１）　平場部施工

　　　　　　　①防湿シート敷き込み（必要な場合）

　　　　　　　　　○　平場部にSPL防湿シートを敷設する。状況に応じて下地にSPLエマルション100を

＠3～5m間隔で塗布し、防湿フィルムを仮固定する。

SPLエマルション100が乳白色から半透明に変わってからSPL防湿シートを敷設す

ること。

　　　　　　　②断熱材敷き込み

* 平場部にポリスチレン系断熱材を敷き込み、SPLディスクをSPLスクリューで固定する。

　　　　　　　　　○　断熱材の敷き込みは突き付けとし、隙間や段差が生じないよう注意する。

* アンカーの締め込み過ぎや緩み、ディスクの変形などに注意し固定すること。

③絶縁　・　緩衝シート敷き込み

　　　　　　　　　○　平場部全体にSPLマットを敷き込む。

　　　　　　　　　○　必要に応じて仮止め用接着剤SPLエマルション１００を塗布する。

　　　　　　　　　○　SPLマットのジョイントは突き付けとし、SPLテープを貼る。

④SPL塩ビ被覆鋼板の固定

　　　　　　　　　○　入隅部にSPL塩ビ鋼板をSPLスクリューで固定する。

　　　　　　　　　○　SPL塩ビ被覆鋼板のジョイントおよび切り使い部は3～5mm程度開SPLアルミテープ

を貼る。切り使い部のビス穴はディンプルパンチを使用してビス穴加工する。

⑤IW ディスクの固定

　　　　　　　　　○　平場部の断熱材上に所定の寸法で墨出しをし、IWディスクスペーサーを設置した後、IWディスクをSPLスクリューで固定する。

* アンカーの締め込み過ぎや緩み、ディスクの変形などに注意し固定すること。

　　　　　　　　　○　断熱材を固定しているSPLディスクと重なる箇所は、必ずずらして固定すること。

* 固定ピッチは、別紙の割付参照。

⑥シーカプランGとSPL塩ビ被覆鋼板の溶融着処理

　　　　　　　　　○　平場部にシーカプランGをしわが出ないように敷き込み、平場外周部のSPL塩ビ被覆鋼板に熱風溶接または溶剤溶着する。

　　　　　　　　　○　溶融着は常に丁寧で確実に行うことを心がける。

　　　　　　　　　○　接合部の状態を入念に確認し、不備があれば熱風溶接機で融着する。

⑦シーカプランG相互の溶融着処理

　　　　　　　　　○　シーカプランG相互の接合幅は４０mm以上とし、常に丁寧で確実な溶融着を心がける。

　　　　　　　　　○　接合部の状態を入念に確認し、不備があれば熱風溶接機で融着する。

　　　　　　　⑧IWディスクとシーカプランGの誘導加熱処理

　　　　　　　　　○　IWディスク固定部にIW自動加熱装置を用いて接合する。

　　　　　　　　　　　 接合方法はIW自動加熱装置に同封の取扱説明書を参照のこと。

　　　　　　　　　○　接合部の状態を確認し、不備があれば再加熱にて適切な接合をする。

　　　　　　　⑨シーカプラン接合末端部のシール処理

　　　　　　　　　○　シーカプラン接合末端部はシームシーラントでシール処理する。

　　　（２）　立上り部施工

　　　　　　　①立上がり下地面への接着剤塗布

○　下地に接着剤（SPLボンド）をむらなく、付属のクシゴテで均一に塗布する。

　　　　　　　　　　　 下地に塗布した接着剤は、完全に乾燥させる。

　　　　　　 ②シーカプラン G裏面への接着剤塗布

○　シーカプラン G裏面に接着剤（SPLボンド）をむらなく、付属のクシゴテで均一

に塗布する。

　　　　　　　 シーカプラン G相互の接合部には接着剤を塗布しない。

　　　　　　 ③シーカプラン Gの貼り付け

　　　　　　○　シーカプラン Gの裏面の接着剤の指触乾燥確認後、割り付け位置に合わ

せてエアーの抱き込みのないように注意してシーカプラン Gを貼り込み、

ローラーなどで転圧する。

シート端部の裏面にはプチルテープを貼り付けること。

④シーカプラン G相互の溶融着処理

　　　　　　　　　○　シーカプラン G相互の接合幅は40mm以上とし、常に丁寧で確実な溶融着を

心がける。

* 接合部の状態を入念に確認し、不備があれば熱風溶接機で融着する。

⑤コーナー部の処理

* コーナーの出入隅部にはSPLコーナーパッチまたはシーカプラン Gをカットした

シートを用いて熱融着する。

○　コーナーの出入隅部には３枚重ねなどシートの段差が多く発生する為、丁寧で確実

な融着を心がける。

⑥防水端末へのアルミ金物の取付け。

* 防水端末部に形状にあったアルミ金物を選定し取り付ける。

⑦シーカプラン接合末端部およびコーナー部のシール処理

　　　　　　　　　○　シーカプラン接合末端部はシームシーラントでシール処理する。

⑧ドレン部の処理

* SPLドレン鋼板を下地形状にあわせ加工し、固定する。
* SPLドレンとタイダクトホースをボンド塩ビパイプ用を使用して接合し、既存パイプに

セットしてから、SPLドレン鋼板に熱風溶接または溶剤溶着する。

* SPLドレン接合末端部はシームシーラントでシール処理する。

**６．　安全管理**

**６－１　一般項目**

　　　　　　　　①　労働基準法等に定められている安全規則と各現場での安全規則を守ること。

　　　　　　　　②　保護帽や作業服は正しく着用すること。

　　　　　　　　③　健康管理は怠らず良好な体調で作業すること。

　　　　　　　　④　工具類は点検し正しく使うこと。

**６－２　危険作業の防止及び禁止項目**

　　　　　　　　①　台風などの強風で危険が予測される場合は、事前に材料・工具等の飛散防止の

養生をし、作業を見合わせる。

　　　　　　　　②　大雨などで危険が予測される場合は、事前に雨養生をし、作業を見合わせる。

　　　　　　　　③　作業中の降雨は落雷に注意し、速やかに階下へ避難すること。

　　　　　　　　④　火の気がある場所で溶剤系の材料を使用しないこと。

　　　　　　　　⑤　つまずきや転倒が起きないように作業場は整理整頓すること。

　　　　　　　　⑥　消火器の設置場所及び使用方法を確認すること。

　　　　　　　　⑦　指定場所以外での喫煙はしないこと。